

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 6 月 3 日(03.06.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/064971 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 23/12 (2006.01) H01L 25/11 (2006.01)
H01L 25/10 (2006.01) H01L 25/18 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/006794
- (22) 国際出願日: 2010 年 11 月 19 日(19.11.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2009-270110 2009 年 11 月 27 日(27.11.2009) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKE-LITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 川田 政和(KAWATA, Masakazu) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 竹内 江津(TAKEUCHI, Etsu) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 楠木 淳也(KUSUNOKI, Junya) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2

丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 杉山 広道(SUGIYAMA, Hiromichi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

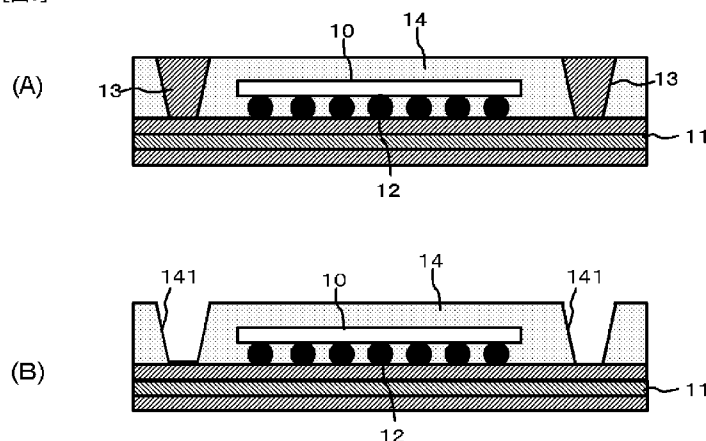
- (74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI, Shinji); 〒1410031 東京都品川区西五反田 7-9-2 五反田 T Gビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

[続葉有]

(54) Title: PRODUCTION METHOD FOR ELECTRONIC DEVICE, ELECTRONIC DEVICE, PRODUCTION METHOD FOR ELECTRONIC DEVICE PACKAGE, AND ELECTRONIC DEVICE PACKAGE

(54) 発明の名称: 電子装置の製造方法、電子装置、電子装置パッケージの製造方法、電子装置パッケージ

[図3]



(57) Abstract: Disclosed is a production method for an electronic device that involves a process for disposing an electronic component (10) upon a base (a substrate) (11); a process for providing an upright section (13) that is erected upon the surface of the base (11) whereon the electronic component (10) has been disposed and that is formed comprising a resin having pyrolytic properties; a process for providing a sealing member (14) in a manner enveloping the aforementioned electronic component (10) and covering around the aforementioned upright section (13), and in a manner such that a portion of the aforementioned upright section (13) protrudes from the surface thereof; a process for forming a hole (141) penetrating the aforementioned sealing member (14) by heating the aforementioned upright section (13) and dissolving and removing the aforementioned upright section (13); and a process for disposing a conductor (15) within the aforementioned hole (141).

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2011/064971 A1